

TM 230 可焊接導電膠 产品数据表

提高可靠性
改善導熱性
消除氣體逸出

简介

TM 230 可焊導電膠是一種快速固化、自填充、自流平、自焊接的黏合劑，可用作LED、CSP、QFP等裝置的晶片黏接膠，以取代導電膠（銀膠）或焊料（如焊膏或預成型焊料）。與導電膠（銀膠）相比，TM 230 可焊導電膠具有更高的電導率和熱導率穩定性，能夠輕鬆填充間隙並使晶片自流平，且易於控制黏接厚度。與傳統焊料相比，TM 230 可焊導電膠消除了焊接過程中的氣體逸出、晶片傾斜和位移以及焊料溢出等問題。TM 230 可焊導電膠固化後，焊接界面將被封裝，從而使焊接金屬界面受到三維聚合物網絡的保護，能夠耐受惡劣的環境條件。

物理特性

产品名称	TM 230 可焊黏合劑
外貌	銀
樹脂類型	環氧樹脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	3.5 – 4.5 g/cc
粘度	30 – 45 kcp
已固化材料性能	
拉伸強度(MPa)	53
C.T.E (ASTM E831) PPM/°C	21.7
楊氏模量 (GPa)	41.6
導熱係數 (w/m.k)	58

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面絕緣電阻(J-STD-004)	經過

推薦固化工藝

在 230°C 下加熱 60 秒。

注意:60 秒的固化時間包括使黏合部位達到所需固化溫度所需的時間。可以評估其他固化方案。

儲存和保存期限

如果將材料保存在密封的原包裝容器中, 並在 -40°C 的溫度下儲存, 保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防潮、防蒸發並防止混入異物。蒸發和污染會嚴重影響這些產品的加工性能。

安全須知

TM230 是一種安全無毒的材料。但是, 建議在處理該材料時遵守一般的衛生操作規範。更多詳細信息, 請參閱我們的安全資料表 (SDS)。

包裝規格

TM 230 可焊膠有 10cc 和 30cc 兩種規格。其他包裝規格可依客戶要求客製化 請聯絡 YINCAE 以取得訂購資訊。